УДК 621.762

О. Н. Кайдаш, канд. техн. наук

Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины,г. Киев

КИНЕТИКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСЛЕНИЯ НАНОКЕРАМИКИ Si₃N₃-Al₂O₃-Y₂O₃-ZrO₂

Обсуждается кинетика высокотемпературного окисления до 1600 °С на воздухе нанокерамики $Si_3N_4-2\%Al_2O_3-5\%Y_2O_3-(0-10\%)ZrO_2$. Установлено, что добавки ZrO_2 существенно влияют на кинетику окисления нитридокремниевой керамики. Небольшие добавки оксида циркония повышают стойкость материала к окислению за счет образования непрерывного слоя кристобалита на поверхности раздела окалина – керамика, который служит барьером для диффузии кислорода. Повышение содержания ZrO_2 до 10% значительно снижает стойкость к окислению.

Ключевые слова: нитрид кремния Si₃N₄, нанокерамика, стойкость к окислению.

Нитрид кремния – соединение с преимущественно сильными ковалентным межатомными связями [1]. Для его уплотнения требуются добавки оксидов Al_2O_3 , Y_2O_3 , образующие жидкую фазу в процессе спекания [2–4]. Добавка ZrO_2 улучшает прочность и вязкость Si_3N_4 -керамики [5–7]. Нашими исследованиями установлено, что использование ZrO_2 обеспечивает в спеченной нанокерамике повышение предела прочности при изгибе до 1100 МПа и вязкости разрушения до 6,5 МПа·м^{1/2} [8]. Нитрид кремния является одной из наиболее перспективных высокотехнологичных керамик, в том числе и для режущего инструмента, поэтому стойкость к окислению является важной характеристикой материала.

Нитрид кремния термодинамически нестабилен в окислительной среде и образует пассивирующий слой SiO₂ с низкой проницаемостью для кислорода. Схематически этот процесс можно описать реакцией

$$\mathrm{Si}_{3}\mathrm{N}_{4}(\mathrm{TB}) + 3\mathrm{O}_{2}(\mathrm{\Gamma}) \to 3\mathrm{Si}\mathrm{O}_{2}(\mathrm{TB}) + 2\mathrm{N}_{2}(\mathrm{\Gamma}) \tag{1}$$

Известно, что керамика $ZrO_2-Y_2O_3-Si_3N_4$ более стойкая к окислению в сравнении с MgO–Si₃N₄ [9] и демонстрирует более высокие механические свойства из-за фазового превращения в диоксиде циркония [5]. Однако влияние ZrO_2 на окисление Si_3N_4 -керамики до конца не изучено. В настоящей работе обсуждается кинетика высокотемпературного окисления $Si_3N_4-Al_2O_3-Y_2O_3-ZrO_2$ -керамики.

Материалы и методы исследования

Состав исходных композиций¹ приведен в табл. 1, технологические подробности получения материалов подробно описаны в [8].

Нанокомпозиция,	Содержание елементов, % (по массе)					
% (по массе)	Y	Al	Zr	Si _{общ}	Si _{cboõ}	С
Si_3N_4 -2 Al_2O_3 -5 Y_2O_3	3,9	1,1	-	55,7	0,6	0,12
$Si_3N_4 - 2Al_2O_3 - 5Y_2O_3 - 5ZrO_2$	3,8	0,9	3,5	52,7	1,2	0,11
$Si_3N_4 - 2Al_2O_3 - 5Y_2O_3 - 10ZrO_2$	3,8	0,9	7,9	50,5	0,9	0,11

Таблица 1. Характеристика исходных порошковых композиций

Исследовали плотные образцы, спеченные до относительной плотности 96–98 %. Вырезали образцы размерами $5 \times 5 \times 10$ мм и $2,5 \times 2,5 \times 5$ мм, их поверхность шлифовалась и полировалась. После очистки в ацетоне и спирте образцы нагревали до температуры 110 °C для испарения растворителей. Процесс окисления изучали на термоанализаторах Q-1500D и Derivatograph-C. После окисления поверхность исследовали рентгеновским фазовым (ДРОН–2) и микрорентгеноспектральным анализами (Camebax SX–50).

Результаты исследований

Рентгеновским фазовым анализом спеченного Si₃N₄-материала определили присутствие кристаллического β -Si₃N₄ и следов Si₂N₂O. В Si₃N₄-ZrO₂-материале кроме этих фаз присутствует стабилизированный Y₂O₃ тетрагональный ZrO₂. В процессе спекания ZrO₂ взаимодействует с Si₃N₄ с образованием оксинитридов кремния и циркония [10]:

 $^{^{1}}$ Далее Si₃N₄–Al₂O₃–Y₂O₃ будем обозначать Si₃N₄

 $Si_3N_4 + ZrO_2 \rightarrow ZrO_{2-2x}N_{3x/4} + Si_2N_2O$

Эта реакция обеспечивает присутствие дополнительного количества Si₂N₂O в процессе спекания Si₃N₄–ZrO₂-керамики. Полученные материалы имеют нанодисперсную структуру с зернами Si₃N₄ размером 0,3–0,5 мкм и включений ZrO₂ размером до 0,6 мкм.

Образцы размером 2,5×2,5×5 мм нагревали на воздухе со скоростью 20 °С/мин до температуры 1600 °С. Измерение показало, что заметный прирост массы на единицу площади начинается с температуры 1000 °С (рис. 1). Дальнейшее нагревание приводит к пропорциональному увеличению прироста массы. В интервале температур 1250–1270 °С прирост массы образцов увеличивается, с температуры 1400 °С для Si₃N₄–10ZrO₂ и 1470 °С для Si₃N₄–5ZrO₂ увеличение резкое. Для Si₃N₄ прирост массы начинается с 1250 °С и его скорость выше, чем для Si₃N₄–5ZrO₂.



Рис. 1. Зависимости удельного прироста массы материалов от температуры окисления: $1 - Si_3N_4$; $2 - Si_3N_4$ -5ZrO₂; $3 - Si_3N_4$ -10ZrO₂. Скорость нагрева 20°С/мин

На кривых ДТА в температурном интервале 1230–1365 °С наблюдается несколько слабых экзотермических пиков, которые, очевидно, соответствуют процессу окисления. При температуре 1540–1570 °С для всех образцов наблюдаются более интенсивные эндотермические пики, появление которых связано с плавлением стеклофазы. Рентгеновский фазовый анализ поверхности образцов Si₃N₄–ZrO₂, окисленных при температурах до 1380 °С, показал присутствие β -кристобалита (SiO₂), дисиликата иттрия (Y₂Si₂O₇) и тетрагонального ZrO₂. В образцах, нагретых до температуры 1520 и 1600 °С, β кристобалит не обнаружен.

Результаты микроструктурного анализа оксидной пленки, образующейся на поверхности образцов Si_3N_4 –10ZrO₂ при температуре 950 °C, показали, что в темном поле присутствуют отдельные включения серой и светлой фаз

(рис. 2, *a*). Темная фаза состоит преимущественно из Si, O; серая – из Y, Si, O, светлая – из Zr, O и небольшого количества Y. Содержание элементов в этих фазах близко соответственно к SiO₂, $Y_2Si_2O_7$, ZrO₂. В образцах, нагретых до температуры 1380 °C, количество серой фазы на наружной поверхности слоя увеличивается (рис. 2*б*) и при температуре 1520 °C пленка β-кристобалита полностью покрывает поверхность образцов. При дальнейшем повышении температуры она плавится, и в ней растворяются серые и светлые включения (рис. 2*в*). Образцы размером 5x5x10 мм выдерживали на воздухе при температуре 1380 °C в течение 60 ч. Результаты измерения прироста массы на единицу площади показали, что окисление Si₃N₄–5ZrO₂-материалов описывается параболическим законом во всем временном интервале (рис. 3). Скорость удельного прироста массы Si₃N₄–10ZrO₂ значительно выше, чем Si₃N₄–5ZrO₂ и отклоняется от параболического закона. Окисление Si₃N₄ происходит иначе. Оно начинается с потери массы, скорость которой с увеличением продолжительности окисления уменьшается. Только после окисления в течение 4 часов наблюдается прирост массы.

Результаты фазового рентгеновского анализа поверхности Si₃N₄–ZrO₂ образцов, окисленных при температуре до 1380 °C, свидетельствуют о наличии β -кристобалита (SiO₂), дисиликата иттрия (Y₂Si₂O₇), тетрагонального диоксида циркония ZrO₂, силиката циркония (ZrSiO₄) и оксинитрида кремния (Si₂N₂O). Пики, принадлежащие β -Si₃N₄, становятся слабее с увеличением продолжительности окисления при температуре 1380 °C. При этом количество Y₂Si₂O₇ и ZrSiO₄ увеличивается и после окисления в течение 20 часов изменяется несущественно (рис. 4). Напротив, количество ZrO₂ постоянно уменьшается. После разрушения оксидной пленки рентгеновский фазовый анализ подслоя под окалиной выявил присутствие Si₂N₂O.

Для оценки распределения элементов в оксидной пленке и подложке (исходном материале) использовали РЭМ. Приготовили шлифы под углом 30° к поверхности образца. Линия сканирования Si₃N₄–5ZrO₂-образца, окисленного при температуре 1380 °C в течение 60 ч, показана на рис. 5.



Рис. 2. Микроструктура окалины, формирующейся на Si_3N_4 –10ZrO₂-керамике при температуре окисления: $a - 950 \, \degree$ за 20 ч; $b - 1380 \, \degree$ за 2 ч; $b - 1600 \, \degree$ за 2 мин



Рис. 3. Зависимости прироста массы на единицу площади от продолжительности окисления материалов при температуре 1380 °C: 1 – Si₃N₄; 2 – Si₃N₄–5ZrO₂; 3 – Si₃N₄–10ZrO₂



Рис. 4. Зависимость интенсивности рентгеновских пиков (I) соединений от продолжительности окисления материала Si₃N₄–5ZrO₂: 1 – Y₂Si₂O₇; 2 – SiO₂; 3 – ZrSiO₄; 4 – ZrO₂

Из анализа следует, что область под стеклофазой обеднена азотом и обогащена кислородом. Результаты изучения окалины свидетельствуют о том, что дисиликат иттрия в основном преобладает ближе к поверхности раздела окалина – воздух в виде отдельных кристаллов, а кристобалит присутствует преимущественно на поверхности раздела нитридная керамика – оксидная пленка. Цирконий и алюминий практически однородно распределены по окалине и подложке.

В результате изучения структуры окалины на Si₃N₄–10ZrO₂ определили, что она богата Zr и Y и прослойка кристобалита на поверхности раздела окалина – керамика не образуется. Наружный слой окалины содержит пузырьки, по-видимому, формирующиеся при захлопывании азота.

Микроструктурным анализом образцов Si₃N₄, окисленных при температуре 1380 °C, на наружной поверхности окалины выявлено большое количество пор, вероятно, возникших в результате разрыва пузырьков с захлопнутым азотом. Микроструктура окалины, образовавшейся на образцах Si₃N₄, близка к структуре окалины на Si₃N₄–5ZrO₂-образцах, в которых дисиликат иттрия присутствует в основном на поверхности раздела окалина – воздух. Выпуск 14. ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ



Рис. 5. Микроструктура оксидного слоя на Si_3N_4 –5 ZrO_2 -керамике, окисленной при температуре 1380 °С в течение 60 ч: а – общий вид участка сканирования; распределение на межфазной поверхности окалина – керамика азота (б) и кислорода (в)

Обсуждение результатов

Состав нитридокремниевой керамики является одним из решающих факторов, определяющих процесс окисления. Зарубежные ученые предположили, что диффузия кислорода в Si₃N₄-материалах является процессом, контролирующим скорость окисления, и поскольку в слое Si₂N₂O более низкая скорость диффузии кислорода, чем в SiO₂, он действует как диффузионный барьер. Добавки тутоплавких оксидов (Y₂O₃, MgO, Al₂O₃) взаимодействуют с SiO₂ и образуют соответствующие силикаты, влияющие на кинетику окисления [11]. Для Si₃N₄-керамики с оксидом магния было подтверждено, что диффузия магния является процессом, лимитирующим окисление [12]. В случае Si₃N₄ с MgO и Y₂O₃ было показано, что тонкая пленка кристобалита на межфазной поверхности Si₃N₄-силикат, является вторым фактором, контролирующим скорость, в дополнение к миграции магния [13]. В Si₃N₄-Y₂O₃-керамике было обнару-

жено, что непрерывный слой $Y_2Si_2O_7$, который образуется между керамикой и SiO₂, является диффузионным барьером для кислорода [14]. Повышению стойкости к окислению также способствуют добавки редкоземельных оксидов [15, 16], образующих стойкую к окислению фазу Re₂Si₂O₇.

Результаты настоящего исследования показали, что добавки ZrO_2 влияют на кинетику окисления нитридокремниевых материалов. Добавки $ZrO_2 \kappa Si_3N_4$ образуют дополнительное количество оксинитрида кремния в процессе спекания исходного материала в соответствии с реакцией (1). Рентгеновский анализ подтвердил более высокое содержание Si_2N_2O в Si_3N_4 – ZrO_2 .

По-видимому, более высокое содержание межзеренной стеклофазы объясняет различную стойкость к окислению Si_3N_4 и Si_3N_4 –ZrO₂. Для Si_3N_4 увеличение прироста массы наблюдается только при температуре 1300 °C, в то время как для Si_3N_4 –ZrO₂ оно начинается с температуры 1100 °C (см. рис. 1). Первые 3 ч изотермического окисления Si_3N_4 при температуре 1380 °C наблюдается уменьшение массы (см. рис. 3). Поверхность окисленного слоя покрыта большим количеством пор, образующихся при удалении азота. Высокое содержание оксинитрида кремния в межзеренной фазе является барьером для проникновения кислорода, и это приводит к тому, что с самого начала кинетика окисления описывается параболическим законом (см. рис. 3), тогда как низкое содержание его в Si_3N_4 приводит к окислению с уменьшением массы вследствие интенсивного удаления азота до тех пор, пока не образуется достаточной толщины пленка SiO_2 . В дальнейшем наблюдается прирост массы и его скорость описывается параболическим законом.

Скорость миграции в межзеренной стеклофазе является одним из факторов, определяющих структуру окисленного слоя. При низкой температуре окисления пленка оксида содержит включения силиката иттрия (серая фаза), образующегося в результате взаимодействия между Y_2O_3 и SiO₂ и частично ZrO₂ (светлая фаза), которая присутствует в верхнем слое (см. рис. 26).

В результате дифференциального термического анализа (ДТА) нагретых в аргоне Si_3N_4 –ZrO₂материалов, обнаружены эндотермические пики при температурах 1235 и 1275 °C, что свидетельствует о появлении жидкой фазы. В жидкой межзеренной фазе скорость миграции должна значительно повыситься. В действительности накопление иттрия в виде $Y_2Si_2O_7$ в оксидном слое наблюдается уже после окисления при температуре 1380 °C в течение 2 ч (см. рис. 26, где $Y_2Si_2O_7$ – серая фаза). Диффузия Y, Al, Zr из межзеренной фазы и их растворение в SiO₂ приводит к образованию стеклофазы следующего состава (мас. %): Si – 36,7; O – 51,0; Y – 2,0; Al – 1,7; Zr – 1,6 и малого количества (следов) Ca, K, Fe.

Изучение процесса окисления с помощью ДТА показало, что плавление оксидного слоя стеклофазы начинается при температуре 1540 °С. Жидкая фаза образуется в соответствии с известной эвтектической температурой 1539 °С в системе SiO₂–Al₂O₃–ZrO₂ [17]. Очевидно, миграция Y, Al, Zr из межзеренной фазы в оксидную пленку и реакции образования силикатов должны определять содержание компонентов в оксидном слое и кинетику окисления Si₃N₄–ZrO₂-материалов. В исходном материале присутствуют иттрий и алюминий в межзеренной фазе, а цирконий в виде включений тетрагонального ZrO₂. Таким образом, следует ожидать, что главным источником Y и Al, поставляющим их в оксидную пленку, является их миграция из межзеренной фазы, в то время как за образование циркониевого силиката отвечает взаимодействие между присутствующими под слоем окисленного материала ZrO₂ и SiO₂. Его количество в оксидном слое, по-видимому, контролируется скоростью реакции (по крайней мере на начальной стадии окисления) и скоростью миграции Zr вглубь оксидной пленки. Количественное изменение этой фазы в оксидной пленке в зависимости от продолжительности окисления (см. рис. 4) показало, что увеличение содержания циркониевого силиката в общем коррелирует с уменьшением содержания диоксида циркония.

Отличительная особенность структуры оксидного слоя, образовавшегося на поверхности $Si_3N_4ZrO_2$ -керамики, состоит в том, что силикат иттрия отделен от нитрида кремния сплошным слоем кристобалита. Алюминий однородно распределен в стеклофазе оксидной пленки. Иттрий накапливается в окалине в виде $Y_2Si_2O_7$, большие включения которого наблюдаются возле поверхности раздела окалина – воздух. Тенденция иттриевого силиката накапливаться возле поверхности окалина–воздух подтверждает, что зародыши иттриевого силиката сначала образуются на исходной поверхности нитрида кремния и впоследствии служат первичными центрами роста силиката иттрия, которые в дальнейшем отодвигаются от нитрида кремния в процессе образования подслоя кристобалита. Цирконий присутствует в окалине в виде включений ZrO_2 или $ZrSiO_4$ и частично растворяется в стеклофазе.

Поскольку диффузия кислорода в кристаллическом SiO₂ – это величина, на несколько порядков ниже, чем в витрифицированном (незакристаллизованном) стекле, и в слое стеклофазы содержится большое количество трещин и пустот, он не может быть эффективным барьером перемещению кислорода. Диффузия кислорода через кристобалит, по-видимому, может рассматриваться как фактор, контролирующий скорость окисления Si₃N₄–5ZrO₂-керамики.

В действительности нагревание образцов Si₃N₄–ZrO₂ до температуры 1500 °C, как показывает рентгеновский фазовый анализ, приводит к исчезновению слоя кристобалита. Очевидно, он растворяется в стеклофазе. Как результат – существенно повышается скорость окисления (см. рис. 1). Дальнейшее плавление стеклофазы при температуре 1540 °C приводит к разрушению защитного слоя окалины.

Результаты изучения распределения азота и кислорода на межфазной поверхности окалина – керамика (Рис. 56 и 56) и рентгеновского фазового анализа показывают присутствие оксинитрида кремния под слоем кристобалита, который, по-видимому, может быть одним из факторов влияния на скорость окисления.

Очевидно, в керамике Si_3N_4 –5ZrO₂ цирконий незначительно влияет на проницаемость слоя кристобалита. Ясно, что присутствие ZrO₂ можно рассматривать как дополнительный источник образования оксинитрида кремния в керамике. Это в конечном итоге приводит к образованию обогащенного Si_2N_2O слоя на поверхности раздела керамика – кристобалит с более низкой проницаемостью для кислорода, чем SiO_2 [11]. Этим обусловливается более низкая скорость окисления в сравнении с Si_3N_4 (см. рис. 1).

Увеличение добавки ZrO₂ до 10% способствует резкому изменению стойкости к окислению нитридокремниевой керамики. Отличительной чертой структуры окалины, образовавшейся на Si₃N₄–10ZrO₂-керамике, является отсутствие непрерывного слоя кристобалита. Рентгеновский анализ показал более высокое содержание циркониевого силиката и значительно более низкое содержание силиката иттрия и Si₂N₂O в окалине в сравнении с окалиной на Si₃N₄–5ZrO₂. Распределение элементов на поверхности раздела окалина – керамике. Напротив, в керамике Si₃N₄–5ZrO₂ концентрация Zr в окалине более высокая, чем Y, и оба элемента распределены по всей глубине окалины. Очевидно, более высокая концентрация Zr обусловливается более высокой скоростью миграции циркония в окалине из Si₃N₄–10ZrO₂-керамики. В действительности более высокое содержание ZrO₂ в Si₃N₄–10ZrO₂-керамике обеспечивает образование большего количества межзеренной фазы, что может повысить скорость миграции Zr из межзеренной фазы в окалину. Микроструктура Si₃N₄–10ZrO₂-керамики содержит большое количество включений в межзеренной фазе.

Таким образом, большое количество межзеренной стеклофазы в Si₃N₄–10ZrO₂-керамике и, как результат, высокая скорость миграции Zr и Y в окалину не обеспечивают формирования сплошного слоя кристобалита. Кристаллизация кристобалита наблюдалась преимущественно по поверхности пор. Вследствие отсутствия эффективного барьера кислород быстро проникает внутрь окалины, содержащей большое количество крупных пор. Это приводит к резкому приросту массы в Si₃N₄–10ZrO₂-керамике, а его зависимость от продолжительности окисления отклоняется от параболического закона (см. рис. 3). Высокая скорость окисления способствует образованию неоднородной поверхности раздела керамика – окалина с глубокими локальными участками внедрения окалины вглубь керамики. Интенсивное удаление азота из реакционной зоны по реакции (1) приводит к образованию большого количества пор и значительному разбуханию слоя окалины.

Выводы

Добавки ZrO_2 к нитридокремниевой керамике обеспечивают образование межзеренной стеклофазы и ее количество в конечном итоге определяет стойкость к окислению Si_3N_4 – ZrO_2 -керамики.

В окисленной Si₃N₄–5ZrO₂-керамике на поверхности раздела окалина – керамика образуется сплошной слой кристобалита, который служит барьером для диффузии кислорода. Повышенное содержание Si₂N₂O в Si₃N₄–5ZrO₂-керамике обеспечивает образование слоя обогащенного оксинитридом на поверхности раздела кристобалит – керамика, что снижает скорость ее окисления в сравнении с Si₃N₄-керамикой.

В Si₃N₄-10ZrO₂-керамике сплошной слой кристобалита не образуется, видимо, из-за высокой скорости миграции Zr и Y из межзеренной стеклофазы в окалину. Быстрое проникновение кислорода сквозь окалину определяет высокую скорость окисления Si₃N₄-10ZrO₂-керамики.

Автор выражает благодарность сотрудникам Института сверхтвердых материалов НАН Украины В. Ю. Кодашу и С. Ф. Кораблеву за помощь при проведении исследований и плодотворную дискуссию.

Обговорюється кінетика високотемпературного окислення до 1600 °С на повітрі нанокераміки $Si_3N_4-2\%Al_2O_3-5\%Y_2O_3-(0-10\%)ZrO_2$. Встановлено, що домішки ZrO_2 істотно впливають на кінетику окислення нітридокремнієвої кераміки. Невеликі домішки оксиду цирконію поліпшують стійкість матеріалу до окислення за рахунок утворення безперервного шару кристобаліту на поверхні розділу окалина – кераміка, який є бар'єром для дифузії кисню. Підвищення вмісту ZrO_2 до 10% значно знижує стійкість до окислення.

Ключові слова: нітрид кремнію Si₃N₄, нанокераміка, стійкість до окислення.

The oxidation behaviour of Si_3N_4 –2% Al_2O_3 –5% Y_2O_3 –(0–10%) ZrO_2 at the temperature up to 1600 °C in air has been discussed. It was found that ZrO_2 additives notably effect the kinetics of oxidation of silicon nitride ceramics. Small amount of ZrO_2 improved the oxidation resistance of material in consequence of a continuous cristobalite layer forms on the glassy scale – ceramics interface providing a barrier to oxygen diffusion. Increase of content ZrO_2 up to 10% considerably decreases resistance to oxidation.

Key words: *silicon nitride* Si₃N₄, *nanoceramic*, *oxidation resistance*.

Литература

- 1. Pierson H. O. Handbook of refractory carbides and nitrides: properties, characteristics, processing and applications. Noyes, Westwood, NJ : William Andrew. Publ., 1996. 343 p. http://books.google.com.ua
- 2. Pressureless sintering of Si_3N_4 with Y_2O_2 and Al_2O_3 / T. Hayashi, H. Munakata, H. Suzuki, H. Saito // J. Mater. Sci. 1986. 21, N 10 P. 3501–3508.
- 3. Abe O. Sintering process of Y_2O_3 and $Al_2O_3\mbox{-doped Si}_3N_4$ // J. Mater. Sci. 1990. 25, N 9. P. 4018–4026.
- Yeh C. H., Hon M. H. Sintering development and oxidation characterization of AlYO₃-doped Si₃N₄ ceramic // Ceram. Inter. – 1995. – 21, N 3. – P. 181–186.
- 5. Lange F. F. Compressive surface stresses developed in ceramics by an oxidation-induced phase change // J. Am. Ceram. Soc. 1980. 63, N 1-2. P. 38–40.
- 6. Rak Z. S., van Tilborg P. J. Microstructure and mechanical properties of Si_3N_4 densified with ZrO_2 and Al_2O_3 / Silicon Nitride 93. Key Eng. Mater. 1994. 89-91. P. 147–152.
- 7. Falk L. K. L. Development of microstructure in Si_3N_4 ceramics formed with additions of ZrO_2 , Y_2O_3 and Al_2O_3 / Silicon Nitride 93. Key Eng. Mater. 1994. 89-91. P. 489–494.
- Кайдаш О. Н., Даниленко Н. В., Верещака В. М. Влияние ZrO₂ на формирование структуры и свойств материалов из нанодисперсных композиций Si₃N₄-Al₂O₃-Y₂O₃ // Сверхтвердые матер. – 1999. – 21, N 6. – Р. 67–76.
- 9. Dutta S., Buzek B. Microstructure, strength, and oxidation of a 10 wt% zyttrite-Si₃N₄ ceramic // J. Am. Ceram. Soc. -1984. 67, N 2. -P. 89–92.
- 10. Kim J. R., Kim C. H. Effects of ZrO_2 and Y_2O_3 dissolved in zyttrite on the densification and the α/β phase transformation of Si_3N_4 in Si_3N_4 – ZrO_2 composite // J. Mater. Sci. 1990. 22, N 1B. P. 493–498.
- 11.Ogbuji L. U. Role of Si_2N_2O in the passive oxidation of chemically-vapor-deposited Si_3N_4 // J. Am. Ceram. Soc. 1992. 75, N 11. P. 2995–3000.
- 12.Cubiciotti D., Lau K. H. Kinetics of oxidation of hot-pressed silicon nitride containing magnesia // J. Am. Ceram. Soc. 1978. 61, N 11-12. P. 512–517.
- 13. Andrews P., Riley F. L. The microstructure and composition of oxide films formed during high temperature oxidation of a sintered silicon nitride // J. Europ. Ceram. Soc. 1989. 5, N 4. P. 245–256.
- 14.Plucknett K. P., Lewis M. H. Microstructure and oxidation behavior of HIPed silicon nitride // Ceram. Eng. Sci. Proc. 1992. 13, N 9-10. P. 991–999.
- 15. The effect of additives on sintering behavior and strength retention in silicon nitride with RE-disilicate / Z. L. Hong, H. Yoshida, Y. Ikuhara et al. // J. Eur. Ceram. Soc. 2002. 22, N 4. P.527–534.
- 16.Additive effects on Si₃N₄ oxidation / volatilization in water vapour / E. J. Opila, R. C. Robinson, D. S. Fox et al. // J. Am. Ceram. Soc. 2003. 86, N 8. P. 1262–1271.
- 17.On the calculation and representation of multicomponent systems / P. Doerner, L.J. Gauckler, H. Krieg et al. // Calphad. 1979. 3, N 4. P. 241–257.

Поступила 2704.11.